

Technisches Datenblatt

WPS II

Wärmeleitpaste



Anwendungsbeispiele

- Optimiert Wärmeleitung zwischen elektronischen Bauelementen und Kühlkörpern mit geringer bis mittlerer Leistungsdichte wie z. B. Halbleiter (Transistoren, Dioden, Thyristoren usw.) sowie andere integrierte Bauteile

Eigenschaften

- Frei von Silikonen
- Sehr gutes Tieftemperaturverhalten

Typische Kenndaten

- Einsatztemperatur: -40 °C bis +150 °C
- Aussehen: weißgrau
- NLGI-Klasse: 2 – 3*

Dickungsmittel	Bentonit/Metalloxide		
Ruhpenetration	1/10 mm	250 - 290	DIN ISO 2137
Wärmeleitfähigkeit bei 25 °C	W/mK	ca. 0,5	Methode PTB**
Ölabscheidung (40 °C/168 h)	%	≤ 2	DIN 51817
Fließdruck bei +20 °C	mbar	≤ 200	DIN 51805
Grundöl	Synthetischer Ester		
Kin. Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	ca. 90	DIN 51562
Kin. Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	ca. 13	DIN 51562

Gebrauchshinweise

- Produkt sollte innerhalb von 6 Monaten ab Produktionsdatum weiterverarbeitet bzw. aufgebraucht sein
- Innerhalb dieser Zeit abgefüllte Tuben haben eine Verwendbarkeit von 3 Jahren ab Abfülldatum
- Vor Serieneinsatz wird eine Produktverträglichkeitsprüfung empfohlen
- Nur für Bauteile ohne Hochfrequenzbeanspruchung

* Angabe bezieht sich auf Ruhpenetration

** Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin (Heizbrückenverfahren)